

PRESSEMITTEILUNG

06 | 2011

KOOPERATIONSVERTRAG SETZT STARTSIGNAL ZUR WEITERENTWICKLUNG DER UMWELTFREUNDLICHEN SAATGUTBEHANDLUNG MIT ELEKTRONEN

Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl-
und Plasmatechnik FEP

Winterbergstraße 28
01277 Dresden

Annett Arnold
PR / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon +49 351 2586-452 | Fax - 55 452
annett.arnold@fep.fraunhofer.de
www.fep.fraunhofer.de

29. November 2011



Am 24. November unterzeichneten die Vorstände der Getreide AG und BayWa AG, der Geschäftsführer der Röber Institut GmbH sowie der Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP in Dresden einen Kooperationsvertrag zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Saatgutbehandlung mit niederenergetischen Elektronen. Der Verbund aus Saatgutaufbereitern, Anlagenbauer und

Forschungsinstitut setzt damit den Startschuss, um das umweltfreundliche Verfahren auf einem neuen Niveau weiterzuentwickeln und am Markt zu etablieren.

Das Verfahren der Saatgutbehandlung mit Elektronen wird bereits seit vielen Jahren in größerem Umfang von der BayWa AG und der Getreide AG angewendet. In den letzten Jahren wurden in Deutschland über 200.000 Hektar Getreide mit elektronenbehandeltem Saatgut bestellt.

In diesem Jahr haben die Getreide AG und BayWa AG die Pilotanlage Wesenitz erworben. Beide Unternehmen sind damit die ersten Lizenznehmer des Verfahrens, welches im Fraunhofer FEP entwickelt wurde. Gemeinsam mit dem Anlagenbauer Röber Institut GmbH soll die Technologie nun weiter an die durch den Markt vorgegebenen Anforderungen angepasst werden. Dabei werden die umfangreichen praktischen Erfahrungen der letzten Jahre mit einfließen. Die Neuentwicklungen sollen die Anlage in ihrer Größe und ihrem Durchsatz flexibler machen. Außerdem soll das Verfahren neben der Behandlung von Getreidesaatgut auf weitere landwirtschaftliche Fruchtarten sowie Gemüsesaatgut ausgedehnt werden.

Die Saatgutbehandlung mit Elektronen ist eine effektive und zuverlässige Methode, um Saatgut von samenbürtigen Krankheitserregern (Pilze, Bakterien, Viren) zu befreien. Durch einen speziellen apparativen Aufbau wirken die Elektronen dabei nur auf der Oberfläche und innerhalb der Samenschale. Die Keimfähigkeit des Saatgutes wird somit nicht beeinträchtigt und ist mindestens gleichwertig mit der des chemisch gebeizten Saatgutes. Das physikalische Verfahren, welches mehrfach für die ökologische Landwirtschaft empfohlen wurde, liefert eine Vielzahl von Vorteilen für Umwelt und Anwender: Saatgutüberschuss kann problemlos verfüttert werden, Schädlinge können keine Resistenzen gegen dieses Verfahren ausbilden und es werden keine chemischen Wirkstoffe eingesetzt. Darüber hinaus werden von den Anwendern besonders die Vermeidung von Beizstaub, die bessere Fließfähigkeit des Saatgutes und der schnellere Feldaufgang positiv bewertet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.fep.fraunhofer.de

PRESSEMITTEILUNG

06 | 2011

Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl-
und Plasmatechnik FEP

Winterbergstraße 28
01277 Dresden

Annett Arnold
PR / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon +49 351 2586-452 | Fax - 55 452
annett.arnold@fep.fraunhofer.de
www.fep.fraunhofer.de

Wissenschaftlicher Kontakt:

Frank-Holm Rögner
Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP
Telefon +49 351 2586-242
frank-holm.roegner@fep.fraunhofer.de

Pressekontakt:

Annett Arnold
Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP
Telefon +49 351 2586-452
annett.arnold@fep.fraunhofer.de



Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zur Weiterentwicklung der Saatguttechnologie:
(vordere Reihe v.l.n.r.) M. Scholze (Geschäftsführer PETKUS Technologie GmbH), P. C. Ehlers
(Mitglied des Vorstandes Getreide AG), Prof. V. Kirchhoff (komm. Institutsleiter Fraunhofer FEP),
Dr. J. Krapf (Mitglied des Vorstandes BayWa AG)
(hintere Reihe v.l.n.r.) Dr. P. Thoren (Geschäftsführer Röber Institut GmbH), A. Prelwitz
(Geschäftsführer Nordkorn Saaten GmbH), F.-H. Rögner (Fraunhofer FEP), Prof. Chr. Metzner
(Fraunhofer FEP), W. Honikel (BayWa AG), R. Schnell (BayWa AG).
© Fraunhofer FEP